

株式会社 アルバック

2024年6月期第1四半期 WEB 決算説明会（2023年11月7日開催）およびアナリストミーティングの主な質疑応答

【投資動向・受注高】

1. **バッテリー投資が1Qに集中したのはなぜか？2Q以降、来期以降はどのようなトレンドか？**

A: バッテリー関連投資はEVバッテリーの小型大容量化、安全性向上に向けた正極集電体のアルミ箔からアルミ両面蒸着膜への置き換え投資が本格化。少しでも早く量産化・製品化を進めようと各社の投資が1Qに集中した。当初年間計画では170億円程度の受注を見込んでいたが、これを上回る可能性は高い。来期以降は更なる投資拡大を目指す各社の第2次投資によりビジネスが更に拡大する見込み。

今後に向けて、フィルムの広幅化など生産性改善による差別化、正極集電体の他のレイヤーでの蒸着巻取技術活用検討など先行開発にも取り組んでいる。

2. **パワーデバイス関連投資が1Qに集中したのはなぜか？2Q以降、来期以降はどのようなトレンドか？**

A: パワーデバイス関連投資は日本・中国ともにSiC投資が1Qに集中し受注が増加した。

日本では、SiCへのシフトが加速化し、6インチSiCの受注が集中した。

中国では前年度に引き続きSiC投資が活発化、1Qに受注が集中した。2Qも受注継続見込みが、下期受注は上期に比べると落ち着く見込み。

日本・中国ともにパワーデバイスの受注は1Q集中により下期にかけて低下するが、期初計画に変更は無い。

来期以降もSiC投資の8インチへのウエハーサイズアップ投資など、日本・中国ともに活発な投資が継続する見込み。

3. **四半期ベースでは過去最高水準だったパワーデバイスの1Q受注約150億円の方式別・地域別・装置別の内訳は？**

A: 8割半ばがSiC関連投資で日本と中国が半々、イオン注入装置が約5割、スパッタ装置が約4割、残り1割が蒸着装置。

日本でもSiC向けイオン注入装置を受注しており、今後は日本でも拡販予定。

4. **半導体メーカーの投資動向について、分野別に教えてほしい**

A: NAND：投資抑制が継続している。来年度以降、回復すると見込んでいる。

DRAM：投資抑制が継続しているが、DRAM投資は再配線層工程などのHBM関連投資が下支えしている。

DRAM投資は下期からの回復を見込んでいる。

ロジック：先端ロジック投資も足下は抑制気味だが、下期からの回復を見込んでいる。

特に北米ロジックメーカーでの採用が決まり、今後の受注を期待。

昨年度新規参入した北米レガシーメーカーからも継続受注が見込まれ、ロジック分野の取引基盤が拡大してきている。

5. 米国による中国半導体輸出規制等の影響は？パワーデバイス等に影響は無いか？

A: 中国の半導体関連は、スポットでいくつか商談が入る程度で、計画としてはそれほど織り込んではいないため影響は少ない。

ビジネスが拡大しているパワーデバイスや各種電子デバイス、バッテリーは規制の対象外でビジネスへの影響はなく、パワーデバイス等の投資は活発化している。

【売上高・利益（率）】

6. 前年同期比、売上総利益率が低くなっているのはなぜか？営業利益率の低下理由は？

A: 前年度は電子デバイス関連で高収益案件が寄与していたが今期はその影響が剥落したこと、半導体関連で利益率の低い評価機売却が1Qに早まったことなどにより売上総利益率が低下した。

新たな工程での評価機の販売は、今後のビジネス拡大につながるものである。

人件費や受注増加に伴う販売費増加などが増加したため、営業利益率も低下した。

7. 2Q以降利益率はどのようにして改善するのか？

A: 受注残高が1,600億円を超えていることもあり、2Q以降は売上増加が利益率の改善を牽引する。

半導体電子を中心にミックス改善も進むが、電子は前年度の高利益率案件の剥落もあり、結果としてそれほど貢献しない。

計画的生産による利益率改善への貢献は来年度後半以降になると考えている。

8. 部品長納期問題はどうなっているのか？

A: 部品の長納期は改善してきている。

残る一部の長納期部品については、計画的生産、先行手配などにより納期短縮の成果が出ている。

急速に成長しているパワーデバイス関連など、一部にサプライヤーの生産能力をオーバーした特殊部品等があり、サプライヤーと協力して能力増強等に取り組んでいる。

9. リードタイムについて、分野別・製品別に教えてほしい

A: 納期リードタイムは、ロジック・メモリー向けスパッタ装置は、計画的生産の効果もあり、3～10ヶ月、電子デバイス関連で、比較的標準化が進んでいるスパッタリング装置や蒸着装置は、3～8ヶ月程度、

電子関連の特型機は、受注後に部品発注を行うため、15か月以上となるものもある。

パワーデバイス用イオン注入装置は受注急増に伴いサプライヤーの生産能力増強が必要な特型部品があるため、10～17か月となっている

10. 1Qの半導体電子部品およびFPDの受注高・売上高の用途別内訳は？

A: 別紙のとおり。

11. 1Qの営業利益率順位は？

A: 別紙のとおり。

以上

別紙：品目別実績 内訳割合・営業利益率順位

●受注高 品目別の内訳割合

受注高	2024/6期 1Q
半導体電子（億円）	285
・メモリ	1割弱
・ロジック	1割半ば
・電子部品	2割弱
・パワー半導体	5割強
・実装	一桁台半ば
FPD（億円）	245
・LCD	1割半ば
・OLED	2割半ば
・バッテリー	6割弱
・その他	数%

●売上高 品目別の内訳割合

売上高	2024/6期 1Q
半導体電子（億円）	194
・メモリ	2割半ば
・ロジック	1割強
・電子部品	3割弱
・パワー半導体	3割強
・実装	1割弱
FPD（億円）	114
・LCD	4割強
・OLED	4割半ば
・バッテリー	1割強
・その他	数%

●営業利益率順位 2024/6期 1Q

順位	品目
1	コンポーネント
2	一般産業
3	半導体電子
4	材料
5	その他
6	FPD

全社平均利益率は
 3) 半導体電子と
 4) 材料との間